# 封装厂半年工作总结范文(共5篇)

来源：网络 作者：夜幕降临 更新时间：2024-06-12

*封装厂半年工作总结范文1在从事混凝土工程相关工作经历中，我先于20xx从事原材料检测，20xx年从事混凝土外加剂研究，20xx年从事混凝土质量控制，基本上对混凝土的运输、浇筑、养护和混凝土质量检验都有一定的认知，能够独立编制混凝土专项施工方...*

**封装厂半年工作总结范文1**

在从事混凝土工程相关工作经历中，我先于20xx从事原材料检测，20xx年从事混凝土外加剂研究，20xx年从事混凝土质量控制，基本上对混凝土的运输、浇筑、养护和混凝土质量检验都有一定的认知，能够独立编制混凝土专项施工方案，以及相关技术交底工作。对混凝土配合比和混凝土裂缝控制的也有较为深入了解，对大体积混凝土和特殊混凝土正在逐步摸索之中。对复配混凝土外加剂也有2年之久，通过拌制试配小样，对新技术、新工艺、新材料进行反复论证和试验。

具体举例：

1、原材料控制。坚持“不接受不合格材料，不储存不合格材料，不生产不合格产品”的“三不”原则。制定更完善，更严格的检验制度，严格控制各种原材料质量。对进场材料按规范要求及时进行检测，做到无漏检、错检。保证用于生产的材料合格率达到100%，不合格的材料坚决拒绝进入公司料场。同时，积极与材料部沟通和协条，尤其做好对连续生产的大方量混凝土的原材料的准备和储备计划工作。加强与材料供应商的沟通工作，力争让原材料在进场前便处于监控中。

2、成本控制。水...

制作的第一步是建立出零件间联机的布线。我们采用负片转印(

PCB生产Subtractive transfer)方式将工作底片表现在金属导体上。这项技巧是将整个表面铺上一层薄薄的铜箔，并且把多余的部份给消除。追加式转印(Additive Pattern transfer)是另一种比较少人使用的方式，这是只在需要的地方敷上铜线的方法，不过我们在这里就不多谈了。如果制作的是双面板，那么PCB的基板两面都会铺上铜箔，如果制作的是多层板，接下来的步骤则会将这些板子黏在一起。正光阻剂(positive photoresist)是由感光剂制成的，它在照明下会溶解(负光阻剂则是如果没有经过照明就会分解)。有很多方式可以处理铜表面的光阻剂，不过最普遍的方式，是将它加热，并在含有光阻剂的表面上滚动(称作干膜光阻剂)。它也可以用液态的方式喷在上头，不过干膜式提供比较高的分辨率，也可以制作出比较细的导线。遮光罩只是一个制造中PCB层的模板。在PCB板上的光阻剂经过UV光曝光之前，覆盖在上面的遮光罩可以防止部份区域的光阻剂不被曝光(假设用的是正光阻剂)。这些被光阻剂盖住的地方，将会变成布线。在光阻剂显影之后，要蚀刻的其它的裸铜部份。

蚀刻过程可以将板子浸到蚀刻溶剂中，或是将溶剂喷在板子上。一般用作蚀刻溶剂的有，氯化铁(Ferric Chloride)，碱性氨(Alkaline Ammonia)，硫酸加过氧化氢(Sulfuric Acid + Hydrogen Peroxide)，和氯化铜(Cupric Chloride)等通过氧化反应将其氧化(如Cu+2FeCl3=CuCl2+2FeCl2)。蚀刻结束后将剩下的光阻剂去除掉。这称作脱膜(Stripping)程序。钻孔与电镀如果制作的是多层PCB板，并且里头包含埋孔或是盲孔的话，每一层板子在黏合前必须要先钻孔与电镀。如果不经过这个步骤，那么就没办法互相连接了。在根据钻孔需求由机器设备钻孔之后，孔璧里头必须经过电镀(镀通孔技术，Plated-Through-Hole technology，PTH)。在孔璧内部作金属处理后，可以让内部的各层线路能够彼此连接。在开始电镀之前，必须先清掉孔内的杂物。这是因为树脂环氧物在加热后会产生一些化学变化，而它会覆盖住内部PCB层，所以要先清掉。清除与电镀动作都会在化学制程中完成。

THT零件通常都用叫做波峰焊接(Wave Soldering)的方式来焊接。这可以让所有零件一次焊接上PCB。首先将接脚切割到靠近板子，并且稍微弯曲以让零件能够固定。接着将PCB移到助溶剂的水波上，让底部接触到助溶剂，这样可以将底部金属上的氧化物给除去。在加热PCB后，这次则移到融化的焊料上，在和底部接触后焊接就完成了。自动焊接SMT零件的方式则称为再流回焊接(Over Reflow Soldering)。里头含有助溶剂与焊料的糊状焊接物，在零件安装在PCB上后先处理一次，经过PCB加热后再处理一次。待PCB冷却之后焊接就完成了，接下来就是准备进行PCB的最终测试了。打样PCB的中文名称为印制电路板又称印刷电路板、印刷线路板是重要的电子部件是电子元器件的支撑体?是电子元器件电气连接的提供者。

。这一点需要特 别注意，不少PCB 板的电路布局和布线都设计得很漂亮、合理，但是疏忽了定位接插件的精确定位，导致 设计的电路无法和其他电路对接。3.元件在二维、三维空间上有无冲突。注意器件的实际尺寸，特别是器件的高度。在焊接免布局的元 器件，高度一般不能超过3mm。4.元件布局是否疏密有序、排列整齐，是否全部布完。在元器件布局的时候，不仅要考虑信号的走向 和信号的类型、需要注意或者保护的地方，同时也要考虑器件布局的整体密度，做到疏密均匀。

5.需经常更换的元件能否方便地更换，插件板插入设备是否方便。应保证经常更换的元器件的更换和 接插的方便和可靠。

姓 名：

国籍： 中国

目前所在地： 天河区

民族： 汉族

户口所在地： 湛江

身材： 175 cm 70 kg

婚姻状况： 已婚

年龄： 29

求职意向及工作经历

人才类型： 普通求职

应聘职位： 质量管理/测试工程师(QA/QC工程师)、产品工艺/制程工程师、

工作年限： 6

职称： 无职称

求职类型： 全职

可到职日期： 随时

月薪要求： 面议

希望工作地区： 珠海

个人工作经历：

公司名称：

起止年月：20xx-07 ～ 20xx-02东莞长安红板电路印刷厂

公司性质： 外商独资

第一章

2、列出20世纪上半叶对半导体产业发展做出贡献的4种不同产业。P2 答：真空管电子学、无线电通信、机械制表机及固体物理。答：高速、耐久性、功率控制能力。缺陷：功耗高。19.场效应晶体管（FET）有什么优点？P49 答：利于提高集成度和节省电能。的最大优势是什么？P49

3、什么时间、什么地点、由谁发明了固体晶体管？P3 答：1947年12月16日在贝尔电话实验室由威廉·肖克利、约翰·巴丁和沃尔特·布拉顿发明了固体晶体管。

5、列出5个集成时代，指出每个时代的时间段，并给出每个时代每个芯片上的元件数。P4

6、什么是硅片？什么是衬底？什么是芯片？

答：芯片也称为管芯（单数和复数芯片或集成电路），硅圆片通常被称为衬底

8、列出集成电路制造的5个重要步骤，简要描述每个步骤。P4

10、列出提高微芯片制造技术相关的三个重要趋势，简要描述每个趋势。P8

11、什么是芯片的关键尺寸？这种尺寸为何重要？P9

13、什么是摩尔定律？它预测了什么？这个定律正确吗？P10

14、自1947年以来靠什么因素使芯片价格降低？给出这种变化的两个原因。

16、描述硅片技师和设备技师的职责。P16

第三章

11.解释pn结反偏时发生的情况。P45

答：导致通过二极管的电流很小，甚至没有电流。12.解释pn结正偏时发生的情况。P45

答：将一正偏施加于pn结，电路中n区电子从偏压电源负极被排斥。多余的电子从负极注入到充满空穴的p区，使n区中留下电子的空穴。同时，p区的空穴从偏压电源正极被排斥。由偏压电源正极提供的空穴中和由偏压电源负极提供的电子。空穴和电子在结区复合以及克服势垒电压大大的减小了阻止电流的行为。只要偏压对二极管能维持一个固定的空穴和电子注入，电流就将持续的通过电路。

13.双极晶体管有多少个电极、结和类型？电极的名称分别是什么？类型名称分别是什么？P46

答：有三电极和两个pn结、两种类型。电极名称：发射极、基极、集电极。类型名称：pnp、．BJT是什么类型的放大器器件？它是怎么根据能量要求影响它的应用的？P47

答：驱动电流的电流放大器件。发射极和集电极都是n型的重掺杂，比如砷或磷。基极是p型杂质硼的轻掺杂。基极载流子减少，基极吸引的电流将明显地比集电极吸引的电流小。这种差别说明了晶体管从输入到输出电流的增益。晶体管能线性地将小的输入信号放大几百倍来驱动输出器件。

18.双极技术有什么显著特征？双极技术的最大缺陷是什么？P48

答：低电压和低功耗。

的两种基本类型是什么？他们之间的主要区别是什么？P50

答：结型（JFET）和金属-氧化物型（MOSFET）半导体。区别是：MOSFET作为场效应晶体管输入端的栅极由一层薄介质与晶体管的其他两极绝缘。JFET的栅极实际上同晶体管其他电极形成物理的pn结。

有哪两种类型？它们怎么区分？P50 答：nMOS(n沟道)和pMOS（p沟道）。每种类型可由各自器件的多数载流子来区分。

第四章

1.列举得到半导体级硅的三个步骤。半导体级硅有多纯？P64

4.描述非晶材料。为什么这种硅不能用于硅片？P65 9.为什么要用单晶进行硅片制造？P67 14.什么是CZ单晶生长法？P68

22.为什么要用区熔法生长硅晶体？P71 23.描述区熔法。P71

25.给出更大直径硅片的三大好处。P72 26.什么是晶体缺陷？P73

37.在直径为200mm及以上硅片中切片是怎么进行的？P77

41.为什么要对硅片表面进行化学机械平坦化？P78 43.列举硅片的7种质量要求。P79

第五章

1.什么是物质的四种形态？试分别描述之。P87

6.描述三种温标，哪一种是科学工作中最常用的温标？P89

8.给出真空的定义。什么是最常用的真空单位，它是怎么定义的？P91

开关电源的PCB设计规范

在任何开关电源设计中，PCB板的物理设计都是最后一个环节，如果设计方法不当，PCB可能会辐射过多的电磁干扰，造成电源工作不稳定，以下针对各个步骤中所需注意的事项进行分析:

二、参数设置相邻导线间距必须能满足电气安全要求，而且为了便于操作和生产，间距也应尽量宽些。最小间距至少要能适合承受的电压，在布线密度较低时，信号线的间距可适当地加大，对高、低电平悬殊的信号线应尽可能地短且加大间距，一般情况下将走线间距设为8mil。

焊盘内孔边缘到印制板边的距离要大于1mm，这样可以避免加工时导致焊盘缺损。当与焊盘连接的走线较细时，要将焊盘与走线之间的连接设计成水滴状，这样的好处是焊盘不容易起皮，而是走线与焊盘不易断开。

三、元器件布局实践证明，即使电路原理图设计正确，印制电路板设计不当，也会对电子设备的可靠性产生不利影响。例如，如果印制板两条细平行线靠得很近，则会形成信号波形的延迟，在传输线的终端形成反射噪声；由于电源、地线的考虑不周到而引起的干扰，会使产品的性能下降，因此，在设计印制电路板的时候，应注意采用正确的方法。每一个开关电源都有四个电流回路：

(1). 电源开关交流回路

(2). 输出整流交流回路

(3). 输入信号源电流回路

(4). 输出负载电流回路输入回路通过一个近似直流的电流对输入电容充电，滤波电容主要起到一个宽带储能作用；类似地，输出滤波电容也用来储存来自输出整流器的高频能量，同时消除输出负载回路的直流能量。所以，输入和输出滤波电容的接线端十分重要，输入及输出电流回路应分别只从滤波电容的接线端连接到电源；如果在输入/输出回路和电源开关/整流回路之间的连接无法与电容的接线端直接相连，交流能量将由输入或输出滤波电容并辐射到环境中去。电源开关交流回路和整流器的交流回路包含高幅梯形电流，这些电流中谐波成分很高，其频率远大于开关基频，峰值幅度可高达持续输入/输出直流电流幅度的5倍，过渡时间通常约为50ns。这两个回路最容易产生电磁干扰，因此必须在电源中其它印制线布线之前先布好这些交流回路，每个回路的三种主要的元件滤波电容、电源开关或整流器、电感或变压器应彼此相邻地进行放置，调整元件位置使它们之间的电流路径尽可能短。建立开关电源布局的最好方法与其电气设计相似，最佳设计流程如下：

・ 放置变压器

・ 设计电源开关电流回路

・ 设计输出整流器电流回路

・ 连接到交流电源电路的控制电路

・ 设计输入电流源回路和输入滤波器 设计输出负载回路和输出滤波器根据电路的\'功能单元，对电路的全部元器件进行布局时，要符合以下原则：

(1) 首先要考虑PCB尺寸大小。PCB尺寸过大时，印制线条长，阻抗增加，抗噪声能力下降，成本也增加；过小则散热不好，且邻近线条易受干扰。电路板的最佳形状矩形，长宽比为3：2或4：3，位于电路板边缘的元器件，离电路板边缘一般不小于2mm。

(2) 放置器件时要考虑以后的焊接，不要太密集.

(3) 以每个功能电路的核心元件为中心，围绕它来进行布局。元器件应均匀、整齐、紧凑地排列在PCB上，尽量减少和缩短各元器件之间的引线和连接, 去耦电容尽量靠近器件的VCC。

(4) 在高频下工作的电路，要考虑元器件之间的分布参数。一般电路应尽可能使元器件平行排列。这样，不但美观，而且装焊容易，易于批量生产。

(5) 按照电路的流程安排各个功能电路单元的位置，使布局便于信号流通，并使信号尽可能保持一致的方向。

(6) 布局的首要原则是保证布线的布通率，移动器件时注意飞线的连接，把有连线关系的器件放在一起。

(7) 尽可能地减小环路面积,以抑制开关电源的辐射干扰。

四、布线开关电源中包含有高频信号，PCB上任何印制线都可以起到天线的作用，印制线的长度和宽度会影响其阻抗和感抗，从而影响频率响应。即使是通过直流信号的印制线也会从邻近的印制线耦合到射频信号并造成电路问题(甚至再次辐射出干扰信号)。因此应将所有通过交流电流的印制线设计得尽可能短而宽，这意味着必须将所有连接到印制线和连接到其他电源线的元器件放置得很近。印制线的长度与其表现出的电感量和阻抗成正比，而宽度则与印制线的电感量和阻抗成反比。长度反映出印制线响应的波长，长度越长，印制线能发送和接收电磁波的频率越低，它就能辐射出更多的射频能量。根据印制线路板电流的大小，尽量加租电源线宽度，减少环路电阻。 同时、使电源线、地线的走向和电流的方向一致，这样有助于增强抗噪声能力。接地是开关电源四个电流回路的底层支路，作为电路的公共参考点起着很重要的作用，它是控制干扰的重要方法。因此，在布局中应仔细考虑接地线的放置，将各种接地混合会造成电源工作不稳定。在地线设计中应注意以下几点：

1. 正确选择单点接地通常，滤波电容公共端应是其它的接地点耦合到大电流的交流地的唯一连接点，同一级电路的接地点应尽量靠近，并且本级电路的电源滤波电容也应接在该级接地点上，主要是考虑电路各部分回流到地的电流是变化的，因实际流过的线路的阻抗会导致电路各部分地电位的变化而引入干扰。在本开关电源中，它的布线和器件间的电感影响较小，而接地电路形成的环流对干扰影响较大，因而采用一点接地，即将电源开关电流回路 （中的几个器件的地线都连到接地脚上，输出整流器电流回路的几个器件的地线也同样接到相应的滤波电容的接地脚上，这样电源工作较稳定，不易自激。做不到单点时，在共地处接两二极管或一小电阻，其实接在比较集中的一块铜箔处就可以。

2. 尽量加粗接地线 若接地线很细，接地电位则随电流的变化而变化，致使电子设备的定时信号电平不稳，抗噪声性能变坏，因此要确保每一个大电流的接地端采用尽量短而宽的印制线，尽量加宽电源、地线宽度，最好是地线比电源线宽，它们的关系是：地线＞电源线＞信号线，如有可能，接地线的宽度应大于3mm，也可用大面积铜层作地线用,在印制板上把没被用上的地方都与地相连接作为地线用。进行全局布线的时候，还须遵循以下原则：

(1).布线方向：从焊接面看，元件的排列方位尽可能保持与原理图相一致，布线方向最好与电路图走线方向相一致，因生产过程中通常需要在焊接面进行各种参数的检测，故这样做便于生产中的检查，调试及检修（注：指在满足电路性能及整机安装与面板布局要求的前提下）。

(2).设计布线图时走线尽量少拐弯，印刷弧上的线宽不要突变，导线拐角应≥90度,力求线条简单明了。

(3).印刷电路中不允许有交叉电路，对于可能交叉的线条，可以用“钻”、“绕”两种办法解决。即让某引线从别的电阻、电容、三极管脚下的空隙处“钻”过去，或从可能交叉的某条引线的一端“绕”过去，在特殊情况下如何电路很复杂，为简化设计也允许用导线跨接，解决交叉电路问题。因采用单面板，直插元件位于top面，表贴器件位于bottom面，所以在布局的时候直插器件可与表贴器件交叠，但要避免焊盘重叠。

3．输入地与输出地本开关电源中为低压的DC－DC，欲将输出电压反馈回变压器的初级，两边的电路应有共同的参考地，所以在对两边的地线分别铺铜之后，还要连接在一起，形成共同的地。

五、检查 布线设计完成后，需认真检查布线设计是否符合设计者所制定的规则，同时也需确认所制定的规则是否符合印制板生产工艺的需求，一般检查线与线、线与元件焊盘、线与贯通孔、元件焊盘与贯通孔、贯通孔与贯通孔之间的距离是否合理，是否满足生产要求。 电源线和地线的宽度是否合适，在PCB中是否还有能让地线加宽的地方。注意： 有些错误可以忽略，例如有些接插件的Outline的一部分放在了板框外，检查间距时会出错；另外每次修改过走线和过孔之后，都要重新覆铜一次。

站在世纪尖端，透视过去一年，工作中的风风雨雨时时在眼前隐现，我从一名产线qc升为一车间ipqc；感谢领导及其同事们对我的培养和关怀，回顾过去一年，我自己有很多的感想和体会，由于自身的素质和业务水平离工作的实际要求还有很大差距。但我能够克服困难，努力学习，端正态度，积极的向其他同仁请教学习，能踏踏实实认真地做好本职工作，以下是我对09年工作的一个总结：

x月，由于受经济危机影响当当，公司不是很忙，上级领导给我找一些学习资料来提升自我，如：

1、如何做到管理零缺陷，讲到三道标准四道检验从中我学到了怎样做一名合格的品质人员，

2、现场成本问题分析与解决能力，从中我又学到怎样降低成本提高生产效率管控品质。

810月，由于我所带产线组长物料以致新老员工不断交替，给我工作带来了一定的困难，车间的报废量、不良品也随首不断地增加，此时；我又要抓质量，又要教新员工，从一知不解到清楚了解，一直到新员工熟练掌握，组长、物料员还要不断地和她们沟通物料

摆放以及上线、收线、换线、转线时我们应该注意什么，人员应该怎么安排才不会堆积，流水线才比较畅通等问题。

1112月，此时公司真正地到了旺季，每天我一楼smt，三楼插件来回穿梭，晚上还要和产线加班加点赶产量，但想想很充实，因为我终于把我这几个月学习到的东西用上了，这两个月由于xxx产品比较多，随着一批新员工到来及来料回用；xxx线圈架高翘；xxx静触头2偏移，波峰焊原先调机员自动离职，输入端输出端来料时间过长，可焊性极差，xxx漏插线，保险丝高翘，xxx掉贴片，五金件不上锡等等问题。我们作为品质人员一刻不能放松，多巡线发现问题及时报找qe分析，找解决措施，已来满足生产需要。

20XX年我们随着新的希望与挑战翻开崭新的一页；如何在以后的工作中取得更好的成绩是我20XX年的目标，也是我考虑已久的问题，在新的一年里我将从以下几个方面展开计划：

1、培训。加强与产线作业员，组长，物料员之间的沟通，建立每个员工应有的责任感和良好的行为习惯，培养作业员工作必须的技能，作业员认识多种产品物料以来保证工作中不出错，将错误扼杀在萌芽状态，如：作业员养成指套、手套、防静电一坐在座位上就戴习惯。

2、执行力。坚持本人工作原则，凡是早会上宣导过的东西，就一定执行下去，并在任务完成后去检查，因为我相信员工都会做好要检查的事情。

3、找个时间。每月最少一次，给插件线新老员工进行电阻色环识别元件极性及各产品共用电阻培训，纪律巩固培训各产品易用错元件培训。

4、严格控制波峰焊点检，防静电点检工作，严格要求物料员填写质量跟单批次号，一周最少一次去仓库合对物料员提供的批次号已便追溯。

最后，愿xxx明天更加美好，辉煌！

**封装厂半年工作总结范文2**

在上半年，因为市场形势剧变，市场产出严重缩水，收款周期比较长，采购部的工作经历了比较严峻的挑战，但在公司领导的正确指引和大力支持下，我们能够较好的完成项目采购任务，按公司规定支付相关款项，做到成本控制有力，供应渠道畅通，在保证公司项目正常实施的同时，维护了公司建立的采购物流渠道，维护了公司的美誉度和信誉度。现将我的工作总结如下：

>一、采购部分

严格按照公司询价、核价、采购管理制度，严格控制采购成本，保质保量完成项目采购任务，保证了公司项目实施的正常进行。努力学习，不断提高业务技能，征询产品信息，完成新项目的设备采购，在总公司帮助下，我们经过积极的努力，全面完成了项目的采购，保证了项目正常实施，同时锻炼了我的能力拓宽了我的知识面，对后期的工作十分有意义。

不断拓宽采购渠道，征询采购信息和最新设备信息，为市场提供产品信息和支持。采购的工作和市场业务工作关联十分紧密，我们根据公司的经营计划和市场部的业务拓展计划，积极拓宽了采购渠道，同时，定期为市场部提供产品信息，保证市场部工作的正常开展，取得了市场部的好评。

在项目采购上尽量争取价格优惠和较长的帐期，严格控制款项支付，保证了公司的正常运营，这是我们去年工作中的重心，因为应收款任务比较艰巨，所以应付款这块控制比较严格，这对我们来说真是巨大的挑战和锻炼，通过我们和供应商的良好沟通和多年关系的积累，付款的控制做的比较好。根据公司的需要，参与部分市场业务工作，取得一定的好成绩，我直接负责xx证券的日常设备采购和供应，从商务谈判、到供货以及后期收款等能较好的完成，取得客户的一直好评。

>二、工作中的缺点和不足

技术水平还需提高，尤其是对产品的具体配置和关键性能指标的理解还要提高，目前，产品的品种越来越丰富，分类也越来越细，采购工作对技术的依赖越来越大，所以提高基本技术能力，对今后的工作具有十分重要的意义。这也是我今后努力的方向。和市场部、工程部门的沟通还需加强和提高，今后要逐步加强和市场部以及工程部门的沟通，严格控制采购供货时间和采购周周期，保证项目的供货的科学合理，争取更低的成本。加强对客户需求的理解，寻求更多的渠道，为客户解决问题，这也是我今后努力的方向。

上半年的工作有成绩也有不足，在公司上市的大好时机鼓励下，我一定会努力学习，不断提高业务水平和综合技能，为公司的发展作出应有的贡献。

**封装厂半年工作总结范文3**

上半年过去了，现对上半年工作做个总结。

>一、思想政治素质方面

为使自己时刻保持清醒的头脑，能够自觉地学习，平时能关心国家大事，廉政自律，积极参加支部活动。

>二、组织领导能力方面

我分管xx工厂综合治理工作、上半年联系xx区保卫科、xx区保卫科，虽然分管科室的工作较为繁杂，联系的校区距离较远，但我每周至少到xx调研一次，以了解情况。

我紧紧抓住主任、科长，充分发挥他们的主观能动性，引导其围绕主题开展工作，依靠职工掌握动态，用自己的人格力量感染人，每有重大活动，都到现场去出主意，拿，现在处办公室建立了每周例会制度，工作井井有条，所分管的三个x区保卫科的工作都得到了所在校区各学院、各部门的认可，综合治理工作在xx区得分名列前茅。

>三、工作作风方面

在平时工作中能多干实事，不发牢骚，注意班子形象，维护班子团结，不利于团结的话不说，不利于团结的事不做，勤勤恳恳干事，老老实实做人，能做到揽事不揽权、谋事不谋虚、干事不误事、补台不拆台，执行完成“一把手”交办的和自己分管的工作，工作不推诿、拖拉，不搞小团体，不拉帮结派，一切从大局出发。

敢于负责，各下属单位的请示，敢拍板，绝不因其他领导不在而推三阻四，敷衍搪塞，有胆量碰硬。敬业精神强，对于处务会决定的事，能督促落实，值班时间决不含糊，不缺岗，不早退，处理好值班期间发生的事情，平时除到自己联系的科室、校区保卫科了解情况外，还深入到其他科室其他校区与职工谈心，谈工作，摸情况。由于与职工接触多，了解的信息多，在处长办公会讨论重大问题时，都能很准确地讲出职工思想动态

上半年结束了，相信我在下半年会做得更好。

**封装厂半年工作总结范文4**

需要细心，耐心，自己焊接安装SMD收音机，掌握SMT组装技术。因为我们有耐心，所以会把贴片组件一个个仔细焊接，小心翼翼，没办法的时候就能发现耳塞坏了。在这次培训中，我还发现了电子产品焊接过程的基本操作技能。SMT电路板的生产工艺设计需要一种专业知识的引领。还了解了SMT元器件、SMC电感、SMD集成电路（so封装、QFP封装、PLCC封装等）。）通过这个训练。在实训过程中，老师还教我们如何使用SMT回流焊机，给我们讲了一些企业的生产设备和操作方法的知识，这些都是书本上学不到的。由此可见，本次培训的目的是让我们更深入地了解电子产品和制造工艺并不局限于电路板，开阔视野。

20至12月   学校电子维修部任技术部组长，负责协调技术部的工作。技术方面修过电视机，收音机，显视器等。

2月至4月       深圳国威电子有限公司当PE技术员，主要负责协助工程师维护各种组装无线电话机的写码机，阳光测试机等机的正常工作，也负责坏机的分析，减少坏机的出现。

206月至1月 在广州杰赛科技股份有限公司任研发部技师。负责通信产品测试，外购件的检验。

203月至6月在广州市轻工学校培训电工并获得电工证

20\_年月10至12月在广东工程职业技术学院培训CAD考证并获得CAD绘图中级证。

英语四级证

2.熟悉51系列单片机原理和应用,掌握汇编语言的程序设计。

3.熟练使用Protel 99进行原理图设计和PCB布局。

4.具有AUTOCAD中级证书，能熟练运用该软件。

6.英语四级考试成绩良好。具有基本的听读写能力。进行一般的英语交流。

本人在读大学期间，专心学习专业知识，特别对模拟电路、数字电路这方面知识比较熟悉，能够分析电路图，还加强对操作能力的训练，常做电子小制作，做有功放器、数字电路控制的七彩灯，声控防盗门铃单片机控制的温度计等作品。英语方面具备基本的听读写能力。

20\_年4月～6月期间，是我在深圳国威电子有限公司实习的时间，在该公司实习期间,经过自己的认真学习及师傅的指教。增强了自己的动手操作能力。能够熟练分析电路图。熟练使用和维护各种无线电话机的检测仪器，能够分析无线电话机出现的各种故障。

**封装厂半年工作总结范文5**

进公司以来，在xx的领导与支持下，在各位同事的密切配合下，爱岗敬业，恪尽职守，较好地完成了自己的本职工作和领导交办的其它工作。现简要回顾总结如下：“忙并收获着，累并快乐着”成了心曲的主旋律，常鸣耳盼。对我而言，20xx年的工作是难忘、环境记最深的一年。工作内容的转换，连环境着工作思想、方法等一系列的适应与调整，（包括工作上的适应与心态上的调整）压力环境来了累的感觉，累中也融进了收获的快乐。

>一、半年来的工作表现

（一）正确处理苦与乐，得与失、个人利益和集体利益的关系，坚持甘于奉献、诚实敬业，经过一年的学习和锻炼，我们在工作上取得一定的进步，细心学习他人长处，改掉自己不足，并虚心向领导、同事请教。

（二）半年来我对自身严格要求，始终把耐得平淡、舍得付出、默默无闻作为自己的准则，始终把作风建设的重点放在严谨、细致、扎实、求实脚踏实地埋头苦干上。在工作中，以制度、纪律规范自己的一切言行，严格遵守公司各项规章制度，尊重领导，团结同志，谦虚谨慎，主动接受来自各方环境的意见，不断改进工作。

>二、工作中的不足与今后的努力方向

半年来的工作虽然取得了一定的成绩，但也存在一些不足，主要是思想解放程度还不够，学习、服务上还不够，和有经验的同事比较还有一定差距，与客户沟通还在基本格式上徘徊，在今后工作中，我一定认真总结经验，克服不足，努力把工作做得更好。

（一）发扬吃苦耐劳精神。面对督查事务杂、任务重的工作性质，不怕吃苦，主动找事干，做到“眼勤、嘴勤、手勤、腿勤”，积极适应各种艰苦环境，在繁重的工作中磨练意志，增长才干。

（二）发扬孜孜不倦的进取精神。加强学习，勇于实践，博览群书，在向书本学习的同时注意收集各类信息，广泛吸取各种“营养”；同时，讲究学习方法，端正学习态度，提高学习效率，努力培养自己具有扎实的理论功底、辩证的思维方法、正确的思想观点、踏实的工作作风。力求把工作做得更好，树立办公室的良好形象。

本文档由站牛网zhann.net收集整理，更多优质范文文档请移步zhann.net站内查找